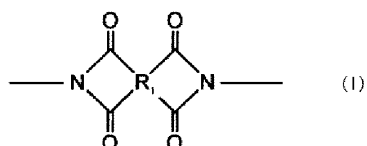


請求の範囲

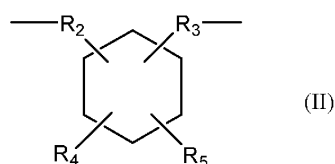
- [請求項1] (A) マレイミド基、少なくとも2つのイミド結合を有する2価の基及び飽和又は不飽和の2価の炭化水素基を有する化合物と、(B) 非ハロゲン系難燃剤と、を含有する、樹脂組成物。
- [請求項2] 前記(B) 非ハロゲン系難燃剤がフェノール系酸化防止剤を含む、請求項1に記載の樹脂組成物。
- [請求項3] 前記(B) 非ハロゲン系難燃剤がホスファイト系酸化防止剤を含む、請求項1に記載の樹脂組成物。
- [請求項4] 前記(B) 非ハロゲン系難燃剤がチオエーテル系酸化防止剤を含む、請求項1に記載の樹脂組成物。
- [請求項5] 前記(B) 非ハロゲン系難燃剤がリン系難燃剤を含む、請求項1に記載の樹脂組成物。
- [請求項6] 前記少なくとも2つのイミド結合を有する2価の基が、下記式(Ⅰ)で表される基である、請求項1～5のいずれか一項に記載の樹脂組成物。

[化1]

[式(Ⅰ)中、R₁は4価の有機基を示す。]

- [請求項7] 前記炭化水素基が下記式(Ⅱ)で表される基である、請求項1～6のいずれか一項に記載の樹脂組成物。

[化2]

[式(Ⅱ)中、R₂及びR₃は各々独立に炭素数4～50のアルキ

レン基を示し、 R_4 は炭素数4～50のアルキル基を示し、 R_5 は炭素数2～50のアルキル基を示す。]

- [請求項8] 前記化合物とは異なるマレイミド基含有化合物を更に含有する、請求項1～7のいずれか一項に記載の樹脂組成物。
- [請求項9] 前記樹脂組成物の硬化物の10GHzでの比誘電率が3.6以下である、請求項1～8のいずれか一項に記載の樹脂組成物。
- [請求項10] 請求項1～9のいずれか一項に記載の樹脂組成物を含む樹脂層及び支持基材を備える、樹脂層付き支持体。
- [請求項11] 請求項1～9のいずれか一項に記載の樹脂組成物と、繊維基材と、から構成される、プリプレグ。
- [請求項12] 請求項1～9のいずれか一項に記載の樹脂組成物の硬化物を含む樹脂層と、導体層と、を有する積層板。
- [請求項13] 請求項1～9のいずれか一項に記載の樹脂組成物の硬化物を含む樹脂層と、少なくとも3層の回路層とを備える、多層プリント配線板。
- [請求項14] 請求項13に記載の多層プリント配線板のミリ波レーダーへの応用。
- [請求項15] 請求項1～9のいずれか一項に記載の樹脂組成物の硬化物を含む樹脂層と、回路層とを備える、ミリ波レーダー用プリント配線板。